

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 16 年 12 月 24 日 (2004.12.24)

【公開番号】特開 2002-373871 (P2002-373871A)
【公開日】平成 14 年 12 月 26 日 (2002.12.26)
【出願番号】特願 2001-181921 (P2001-181921)
【国際特許分類第 7 版】

H 0 1 L 21/301

【F I】

H 0 1 L 21/78 M

H 0 1 L 21/78 P

H 0 1 L 21/78 Q

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 1 月 29 日 (2004.1.29)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 1】

本発明においては、研削工程又はノ及びダイシング工程において、上記補強半導体ウエハ薄膜を研削用テープ又はダイシングテープに貼り付けた状態で加工する。上記補強半導体ウエハ薄膜を研削用テープ又はダイシングテープに貼り付けた状態としては、図 1 に示すように支持体が研削用テープ又はダイシングテープに接している態様であってもよく、図 2 に示すように半導体ウエハが研削用テープ又はダイシングテープに接している態様であってもよい。ただし、半導体ウエハの裏面が研削される際には支持体が研削用テープに接している態様が好ましい。

上記研削用テープ又はダイシングテープとしては特に限定されないが、公知の光硬化性粘着テープを用いることができ、例えば、Adwill (登録商標) D - シリーズや、日東電工社製のエレップホルダー (登録商標) UE シリーズ等のテープが挙げられる。

また、公知の加熱発泡型粘着テープも用いられており、例えば、日東電工社製のリバアルファ (登録商標) が挙げられる。